

# 2025-2030年全球及中国芯片设计（半导体IC设计）行业发展前景展望 与投资战略规划分析报告

## 目 录

### CONTENTS

#### ——综述篇——

#### 第1章：芯片设计综述/产业画像/研究说明

##### 1.1 芯片设计产业综述

###### 1.1.1 芯片设计的界定

###### 1、芯片设计的定义

###### 2、芯片设计的流程

###### 1.1.2 芯片设计的价值

###### 1.1.3 芯片设计所处行业

###### 1.1.4 芯片设计市场监管

###### 1.1.5 芯片设计标准规范

##### 1.2 芯片设计产业画像

###### 1.2.1 芯片设计产业链结构示意图

###### 1.2.2 芯片设计产业链生态全景图

###### 1.2.3 芯片设计产业链区域热力图

##### 1.3 芯片设计研究说明

###### 1.3.1 本报告研究范围界定

###### 1.3.2 本报告权威数据来源

###### 1.3.3 本报告研究统计方法

#### ——现状篇——

#### 第2章：全球芯片设计行业发展现状分析

##### 2.1 全球芯片设计行业发展历程

##### 2.2 全球芯片设计市场规模体量

##### 2.3 全球芯片设计区域发展格局

##### 2.4 全球芯片设计重点区域分析——美国

##### 2.5 全球芯片设计市场竞争态势

###### 2.5.1 全球芯片设计市场竞争格局

###### 2.5.2 全球芯片设计市场集中度

###### 2.5.3 全球芯片设计并购交易态势

###### 2.5.4 全球芯片设计投融资动态

##### 2.6 全球半导体产业及芯片设计

###### 2.6.1 全球半导体产业发展现状分析

###### 2.6.2 全球芯片设计细分市场概况

###### 2.6.3 全球芯片设计细分领域企业

##### 2.7 国外芯片设计发展经验借鉴

##### 2.8 全球芯片设计市场前景预测

##### 2.9 全球芯片设计发展趋势洞悉

#### 第3章：中国芯片设计行业发展现状分析

##### 3.1 中国芯片设计行业发展历程

##### 3.2 中国芯片设计市场规模体量

##### 3.3 中国芯片设计商业运营模式

###### 3.3.1 IDM模式

###### 3.3.2 Fabless模式

###### 3.3.3 Fundary模式

##### 3.4 中国芯片设计企业数量变化

##### 3.5 中国芯片设计能力/服务水平

##### 3.6 中国芯片设计招标投标采购

###### 3.6.1 芯片设计招标投标模式/政策

###### 3.6.2 芯片设计招标投标/采购汇总

###### 3.6.3 芯片设计招标投标/采购规模

- 3.6.4 芯片设计招标投标/采购分析
- 3.7 中国芯片设计行业经营效益
  - 3.7.1 中国芯片设计销售过亿企业数量
  - 3.7.2 中国芯片设计销售过亿企业分布
  - 3.7.3 中国芯片设计企业盈利比例变化
  - 3.7.4 中国芯片设计企业的毛利率水平
- 3.8 中国芯片设计行业发展痛点/挑战
- 第4章：中国芯片设计市场竞争及投融资
  - 4.1 中国芯片设计行业竞争对手分析【同业竞争者】
    - 4.1.1 中国芯片设计现有直接竞争者的竞争程度
    - 4.1.2 中国芯片设计潜在/跨界竞争者的进入威胁
    - 4.1.3 中国芯片设计替代品竞争者份额争夺威胁
  - 4.2 中国芯片设计行业竞争态势矩阵（CPM矩阵）
    - 4.2.1 中国芯片设计企业关键成功因素KSF
    - 4.2.2 中国芯片设计行业竞争者的竞争势头
    - 4.2.3 中国芯片设计行业竞争者的战略集群
  - 4.3 中国芯片设计市场竞争结构分析/差异化竞争
    - 4.3.1 中国芯片设计行业所处生命周期阶段
    - 4.3.2 中国芯片设计行业市场集中度【CRn】
    - 4.3.3 中国芯片设计行业产品差异化程度
  - 4.4 中国芯片设计市场竞争梯队分布
  - 4.5 中国芯片设计市场竞争格局分析
  - 4.6 中国芯片设计企业投资并购态势
    - 4.6.1 中国芯片设计企业投资布局
    - 4.6.2 中国芯片设计企业兼并重组
  - 4.7 中国芯片设计企业融资情况解读
    - 4.7.1 中国芯片设计企业融资渠道
    - 4.7.2 中国芯片设计企业IPO动态
    - 4.7.3 中国芯片设计企业融资事件
    - 4.7.4 中国芯片设计企业融资规模
    - 4.7.5 中国芯片设计热门融资赛道
  - 4.8 中国芯片设计企业国内外竞争力
    - 4.8.1 中国市场：芯片设计企业VS外资企业
    - 4.8.2 海外市场：中国芯片设计企业全球竞争力
  - 4.9 中国芯片设计行业国产替代进程
    - 4.9.1 中国芯片设计国产化进程及国产化率
    - 4.9.2 中国芯片设计细分赛道国产替代空间
- 第5章：中国芯片设计技术进展及供应链
  - 5.1 芯片设计竞争力及进入壁垒
    - 5.1.1 芯片设计核心竞争力/护城河——人才+架构+工具
    - 5.1.2 芯片设计技术壁垒/进入壁垒
  - 5.2 中国芯片设计人才缺口明显
    - 5.2.1 中国芯片设计人才短缺现状
    - 5.2.2 中国芯片设计人才缺口原因
      - 1、芯片设计对人才要求高
      - 2、芯片设计人才培养周期长
      - 3、芯片设计人才流失率高
    - 5.2.3 芯片设计企业人员规模分布
    - 5.2.4 中国芯片设计从业人员规模
    - 5.2.5 中国芯片设计人均产值规模
    - 5.2.6 中国芯片设计企业研发人员
  - 5.3 中国芯片设计研发投入不足
    - 5.3.1 芯片设计企业研发投入力度/强度
    - 5.3.2 芯片设计企业研发项目/投入方向
    - 5.3.3 芯片设计知识产权统计/专利技术
    - 5.3.4 芯片设计科研创新动态/论文发表
    - 5.3.5 芯片设计技术研发方向/未来重点
  - 5.4 中国芯片设计产业生态不完善
    - 5.4.1 中国芯片设计产业生态有待继续完善

- 5.4.2 中国芯片设计企业人力成本不断提高
  - 5.5 供应链：芯片架构/指令级架构**
    - 5.5.1 芯片架构/指令级架构概述
    - 5.5.2 芯片架构/指令级架构市场概况
    - 5.5.3 芯片架构/指令级架构——X86
      - 1、X86概述
      - 2、X86市场概况
      - 3、X86供应商格局
    - 5.5.4 芯片架构/指令级架构——ARM架构
      - 1、ARM架构概述
      - 2、ARM架构市场概况
      - 3、ARM架构供应商格局
    - 5.5.5 芯片架构/指令级架构——RISC-V
      - 1、RISC-V概述
      - 2、RISC-V市场概况
      - 3、RISC-V供应商格局
    - 5.5.6 芯片架构/指令级架构——MIPS架构
      - 1、MIPS架构概述
      - 2、MIPS架构市场概况
      - 3、MIPS架构供应商格局
  - 5.6 供应链：芯片设计EDA软件**
    - 5.6.1 芯片设计EDA软件概述
    - 5.6.2 芯片设计EDA软件市场概况
    - 5.6.3 芯片设计EDA软件供应商格局
  - 5.7 供应链：半导体IP授权/IP核**
    - 5.7.1 半导体IP授权/IP核概述
    - 5.7.2 半导体IP授权/IP核市场概况
    - 5.7.3 半导体IP授权/IP核供应商格局
  - 5.8 供应链：半导体设计仿真/验证**
    - 5.8.1 半导体设计模拟仿真概述
    - 5.8.2 半导体设计模拟仿真市场概况
    - 5.8.3 芯片设计后端验证及第三方检测
  - 5.9 供应链：半导体版图设计/掩膜版制造**
    - 5.9.1 半导体版图设计概述
    - 5.9.2 半导体版图设计软件
    - 5.9.3 光刻掩膜版（光罩）市场概况
  - 5.10 芯片设计的供应链管理挑战**
- 第6章：中国芯片设计细分市场发展分析**
- 6.1 芯片设计细分产品综合对比**
  - 6.2 芯片设计行业细分市场概况**
    - 6.2.1 芯片设计细分市场概况
    - 6.2.2 芯片设计细分市场结构
  - 6.3 芯片设计细分市场：模拟IC芯片设计**
    - 6.3.1 模拟IC芯片设计概述
    - 6.3.2 模拟IC芯片设计市场概况
    - 6.3.3 模拟IC芯片设计竞争格局
    - 6.3.4 模拟IC芯片设计发展前景
  - 6.4 芯片设计细分市场：逻辑IC芯片设计**
    - 6.4.1 逻辑IC芯片设计概述
    - 6.4.2 逻辑IC芯片设计市场概况
    - 6.4.3 逻辑IC芯片设计竞争格局
    - 6.4.4 逻辑IC芯片设计发展前景
  - 6.5 芯片设计细分市场：功率半导体设计**
    - 6.5.1 功率半导体设计概述
    - 6.5.2 功率半导体设计市场概况
    - 6.5.3 功率半导体设计竞争格局
    - 6.5.4 功率半导体设计发展前景
  - 6.6 芯片设计细分市场：射频芯片设计**
    - 6.6.1 射频芯片设计概述

- 6.6.2 射频芯片设计市场概况
- 6.6.3 射频芯片设计竞争格局
- 6.6.4 射频芯片设计发展前景
- 6.7 芯片设计细分市场：存储芯片设计**
  - 6.7.1 存储芯片设计概述
  - 6.7.2 存储芯片设计市场概况
  - 6.7.3 存储芯片设计竞争格局
  - 6.7.4 存储芯片设计发展前景
- 6.8 芯片设计细分市场战略地位分析**
- 第7章：中国芯片设计细分应用市场分析**
  - 7.1 芯片设计客户类型及需求特征**
    - 7.1.1 中国芯片设计客户类型
    - 7.1.2 中国芯片设计需求特征
    - 7.1.3 芯片设计客户议价能力
  - 7.2 芯片设计应用场景及领域分布**
    - 7.2.1 芯片设计潜在应用场景
    - 7.2.2 芯片设计应用领域分布
  - 7.3 芯片设计应用场景：通信芯片设计**
    - 7.3.1 通信领域芯片设计需求概述
    - 7.3.2 通信领域芯片设计市场现状
    - 7.3.3 通信领域芯片设计需求潜力
  - 7.4 芯片设计应用场景：消费电子芯片设计**
    - 7.4.1 消费电子领域芯片设计需求概述
    - 7.4.2 消费电子领域芯片设计市场现状
    - 7.4.3 消费电子领域芯片设计需求潜力
  - 7.5 芯片设计应用场景：计算机**
    - 7.5.1 计算机领域芯片设计需求概述
    - 7.5.2 计算机领域芯片设计市场现状
    - 7.5.3 计算机领域芯片设计需求潜力
  - 7.6 芯片设计细分应用战略地位分析**
- 第8章：全球及中国芯片设计企业案例解析**
  - 8.1 全球及中国芯片设计企业梳理对比**
  - 8.2 全球芯片设计企业案例分析【不分先后，可指定】**
    - 8.2.1 英伟达
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、企业芯片设计业务布局
      - 4、企业芯片设计在华布局
    - 8.2.2 高通
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、企业芯片设计业务布局
      - 4、企业芯片设计在华布局
    - 8.2.3 博通
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、企业芯片设计业务布局
      - 4、企业芯片设计在华布局
    - 8.2.4 超威
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、企业芯片设计业务布局
      - 4、企业芯片设计在华布局
    - 8.2.5 联发科
      - 1、企业基本信息
      - 2、企业经营情况
      - 3、企业芯片设计业务布局
      - 4、企业芯片设计在华布局
  - 8.3 中国芯片设计企业案例分析【不分先后，可指定】**

- 8.3.1 紫光国芯微电子股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.2 上海韦尔半导体股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.3 华润微电子有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.4 三安光电股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.5 斯达半导体股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局

- 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.6 海光信息技术股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.7 苏州纳芯微电子股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.8 兆易创新科技集团股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.9 江苏卓胜微电子股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及投融资
    - (1) 经营情况/营业收入
    - (2) 产品结构/主营业务
    - (3) 销售区域/国内国外
    - (4) 融资历程/对外投资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势
- 8.3.10 扬州扬杰电子科技股份有限公司
  - 1、企业基本信息
  - 2、企业经营情况及融资
  - 3、企业经营资质/能力资质
  - 4、企业研发投入/专利技术
  - 5、企业芯片设计能力/业务布局
  - 6、企业芯片设计应用/客户布局
  - 7、企业发展战略&优劣势

——展望篇——

第9章：中国芯片设计行业政策环境/PEST/SWOT

- 9.1 中国芯片设计行业政策汇总解读【P】
  - 9.1.1 中国芯片设计行业政策汇总
  - 9.1.2 中国芯片设计行业发展规划
  - 9.1.3 中国芯片设计重点政策解读
  - 9.1.4 各地芯片设计政策规划汇总
  - 9.1.5 各地芯片设计的政策热力图
  - 9.1.6 各地芯片设计发展目标解读
- 9.2 中国芯片设计行业经济社会环境
  - 9.2.1 中国芯片设计经济环境分析【E】
  - 9.2.2 中国芯片设计社会环境分析【S】
- 9.3 中国芯片设计行业PEST环境总结
- 9.4 中国芯片设计行业SWOT分析图
- 第10章：中国芯片设计行业发展潜力及前景展望
  - 10.1 中国芯片设计行业发展潜力评估
  - 10.2 中国芯片设计行业未来关键增长点
  - 10.3 中国芯片设计行业发展前景预测
  - 10.4 中国芯片设计行业发展趋势洞悉
    - 10.4.1 中国芯片设计行业整体发展趋势
    - 10.4.2 中国芯片设计行业细分市场趋势
    - 10.4.3 中国芯片设计行业技术创新趋势
    - 10.4.4 中国芯片设计行业市场竞争趋势
    - 10.4.5 中国芯片设计行业市场供需趋势
- 第11章：中国芯片设计行业发展机遇及策略建议
  - 11.1 中国芯片设计行业投资风险预警
    - 11.1.1 中国芯片设计行业投资风险预警
    - 11.1.2 中国芯片设计行业投资风险应对
  - 11.2 中国芯片设计行业投资机遇分析——全产业链配套
    - 11.2.1 不足：芯片设计产业链薄弱点投资机会
    - 11.2.2 欠缺：芯片设计产业链空白点投资机会
  - 11.3 中国芯片设计行业投资机遇分析——细分领域布局
    - 11.3.1 中游：芯片设计细分产品服务布局机会
    - 11.3.2 下游：芯片设计细分应用领域布局机会
  - 11.4 中国芯片设计行业投资机遇分析——优势区域布局
    - 11.4.1 国内：芯片设计行业优势区域投资机会
    - 11.4.2 海外：芯片设计海外投资布局/出海机会
  - 11.5 中国芯片设计行业投资价值评估
  - 11.6 中国芯片设计行业投资策略建议
  - 11.7 中国芯片设计行业可持续发展建议

## 图表目录

- 图表1：芯片设计的定义
- 图表2：芯片设计的流程
- 图表3：芯片设计的价值
- 图表4：芯片设计所处行业
- 图表5：芯片设计监管体系
- 图表6：芯片设计监管机构
- 图表7：芯片设计标准体系
- 图表8：芯片设计标准汇总
- 图表9：芯片设计产业链结构示意图
- 图表10：芯片设计产业链生态全景图
- 图表11：芯片设计产业链区域热力图
- 图表12：本报告研究范围界定
- 图表13：本报告权威数据来源
- 图表14：本报告研究统计方法
- 图表15：全球芯片设计行业发展历程

- 图表16: 全球芯片设计市场规模体量
- 图表17: 全球芯片设计区域发展格局
- 图表18: 美国芯片设计行业发展概况
- 图表19: 全球芯片设计市场竞争格局
- 图表20: 全球芯片设计市场集中度
- 图表21: 全球芯片设计并购交易态势
- 图表22: 全球芯片设计投融资动态
- 图表23: 全球半导体产业发展现状分析
- 图表24: 全球芯片设计细分市场概况
- 图表25: 全球芯片设计细分领域企业
- 图表26: 国外芯片设计发展经验借鉴
- 图表27: 全球芯片设计市场前景预测（2025-2030年）
- 图表28: 全球芯片设计发展趋势洞悉
- 图表29: 中国芯片设计行业发展历程
- 图表30: 中国芯片设计市场规模体量
- 图表31: 2015-2024年中国集成电路设计业销售额（单位：亿元，%）
- 图表32: 中国芯片设计企业数量变化
- 图表33: 中国芯片设计能力/服务水平
- 图表34: 中国芯片设计企业业务能力
- 图表35: 中国芯片设计招标投标模式/政策
- 图表36: 中国芯片设计招标投标/采购汇总
- 图表37: 中国芯片设计招标投标/采购规模
- 图表38: 中国芯片设计集中招标采购分析
- 图表39: 中国芯片设计企业的毛利率水平
- 图表40: 中国芯片设计行业发展痛点/挑战
- 图表41: 中国芯片设计现有直接竞争者的竞争程度
- 图表42: 中国芯片设计潜在竞争者的进入威胁
- 图表43: 中国芯片设计替代品竞争者份额争夺威胁
- 图表44: 中国芯片设计关键成功因素KSF
- 图表45: 中国芯片设计行业竞争者的竞争势头
- 图表46: 中国芯片设计行业竞争者的战略集群
- 图表47: 中国芯片设计行业所处生命周期阶段
- 图表48: 中国芯片设计行业市场集中度【CRn】
- 图表49: 中国芯片设计市场竞争梯队分布
- 图表50: 中国芯片设计市场竞争梯队分布
- 图表51: 中国芯片设计市场竞争格局
- 图表52: 中国芯片设计企业投资布局
- 图表53: 中国芯片设计企业兼并重组
- 图表54: 中国芯片设计企业融资渠道
- 图表55: 中国芯片设计企业IPO动态
- 图表56: 中国芯片设计企业融资事件
- 图表57: 中国芯片设计企业融资规模
- 图表58: 中国芯片设计热门融资赛道
- 图表59: 芯片设计外企在华市场竞争力
- 图表60: 芯片设计外企在华布局动态
- 图表61: 芯片设计核心竞争力/护城河
- 图表62: 芯片设计技术壁垒/进入壁垒
- 图表63: 芯片设计企业研发人员数量
- 图表64: 芯片设计企业研发投入力度/强度
- 图表65: 芯片设计企业研发项目/投入方向
- 图表66: 芯片设计知识产权统计/专利技术
- 图表67: 芯片设计科研创新动态/论文发表
- 图表68: 芯片设计技术研发方向/未来重点
- 图表69: 中国芯片设计产业生态有待继续完善
- 图表70: 中国芯片设计企业人力成本不断提高
- 图表71: 芯片架构/指令级架构概述
- 图表72: 芯片架构/指令级架构市场概况
- 图表73: 芯片设计EDA软件概述
- 图表74: 芯片设计EDA软件市场概况

- 图表75: 半导体IP授权/IP核概述  
图表76: 半导体IP授权/IP核市场概况  
图表77: 芯片设计后端验证及第三方检测  
图表78: 芯片设计的供应链管理挑战  
图表79: 芯片设计细分产品综合对比  
图表80: 芯片设计细分市场概况  
图表81: 芯片设计细分市场结构  
图表82: 模拟IC芯片设计概述  
图表83: 模拟IC芯片设计市场概况  
图表84: 模拟IC芯片设计竞争格局  
图表85: 模拟IC芯片设计发展趋势  
图表86: 逻辑IC芯片设计概述  
图表87: 逻辑IC芯片设计市场概况  
图表88: 逻辑IC芯片设计竞争格局  
图表89: 逻辑IC芯片设计发展前景  
图表90: 功率半导体设计概述  
图表91: 功率半导体设计市场概况  
图表92: 功率半导体设计竞争格局  
图表93: 功率半导体设计发展前景  
图表94: 芯片设计细分市场战略地位分析  
图表95: 芯片设计下游客户类型  
图表96: 芯片设计市场需求特征  
图表97: 芯片设计潜在应用场景  
图表98: 芯片设计应用领域分布  
图表99: 通信领域芯片设计需求概述  
图表100: 通信领域芯片设计市场现状  
图表101: 通信领域芯片设计需求潜力  
图表102: 消费电子领域芯片设计需求概述  
图表103: 消费电子领域芯片设计市场现状  
图表104: 消费电子领域芯片设计需求潜力  
图表105: 计算机领域芯片设计需求概述  
图表106: 计算机领域芯片设计市场现状  
图表107: 计算机领域芯片设计需求潜力  
图表108: 芯片设计细分应用波士顿矩阵分析  
图表109: 全球及中国芯片设计企业梳理对比  
图表110: 全球芯片设计企业案例分析说明  
图表111: 英伟达基本情况  
图表112: 英伟达经营情况  
图表113: 英伟达芯片设计业务布局  
图表114: 英伟达芯片设计在华布局  
图表115: 高通基本情况  
图表116: 高通经营情况  
图表117: 高通芯片设计业务布局  
图表118: 高通芯片设计在华布局  
图表119: 博通基本情况  
图表120: 博通经营情况  
略· · · · 完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：[service@qianzhan.com](mailto:service@qianzhan.com)

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！